



기종명

PSX307A

기판 레벨,
웨이퍼 레벨
PKG로 대응

품번: NM-EFP3A

- 기판이나 웨이퍼 표면을 플라즈마로 세척·품질 개선하여 금속 접합성과 수지밀착성 향상
- 진공 챔버의 대형화에 따라 동시 처리 가능한 기판 장수가 늘어남으로써 생산성 향상
- 독자적인 플라즈마 모니터 기능으로 플라즈마 안정성을 실시간으로 모니터링하여 이상 방전에 의한 기판 손상 억제
- Traceability 기능을 새로 더해 공정 품질 보장
- 다양한 생산 형태에 대응하여 공정 운영을 보다 유연하게 지원
- ϕ 300 mm 웨이퍼(링 포함/불포함)에 대응하여 웨이퍼 레벨 PKG의 제조에 기여



※ 옵션 구성과 고객 사양에 따라 표준 규격 및 EMC 규격에 적합하지 않을 수 있습니다.

*

기종명	PSX307A		
품번	NM-EFP3A		
클리닝 방식	고주파 평행 평반 역스퍼터 방식		
방전용 가스	아르곤 가스(Ar) *1 (옵션: O ₂ , 질소+헬륨)		
전원	단상 AC 200 / 208 / 220 / 230 / 240 \pm 10 V, 50 / 60 Hz, 6.0 kVA		
공압원	0.49 MPa, 50 L / min (A.N.R)		
설비크기	W 900 mm \times D 1,150 mm \times H 1,650 mm *2		
설비무게	630 kg *3		

사양 (대상 작업) *4	기판사양	링 있는 웨이퍼 사양	링 없는 웨이퍼 사양
사이즈 *5	L 50 mm \times W 30 mm *6 ~ L 350 mm \times W 350 mm	ϕ 300 *7	ϕ 300

※ 자세한 내용은 사양설명서를 참조해주시기 바랍니다.
※ 고객님 작업에 대해 사전 확인이 필요합니다.

*1: 방전용 가스로 옵션인 산소를 선택할 경우, 배기 회석용 질소 가스가 별도로 필요합니다.
*2: 터치 패널, 비상 정지 SW, 시그널 타워 불포함
*3: 플룸선인 경우

*4: 사양(대상 작업)은 한 가지 선택 필수
*5: 두께에 대해서는 별도 문의주시기 바랍니다.
*6: W30 이하인 경우 별도 문의주시기 바랍니다.
*7: 링 외형 ϕ 380 mm

반도체 웨이퍼 공정에서 조립 공정까지, 플라즈마 세척과 품질 개선으로 제조 품질 향상

